

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

合肥晶合集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	德邦电子、华泰资产
会议时间	2024年7月23日
会议地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黄凯全 企业规划室部经理 曹宗野 证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、根据公司发布的业绩预告，公司上半年业绩同比增长较好，请问增长的原因是什么？对下半年的展望如何？</p> <p>答复：公司上半年预计实现营业收入 430,000.00 万元至 450,000.00 万元，同比增长 44.80%至 51.53%；预计实现归属于母公司所有者的净利润 15,000.00 万元到 22,000.00 万元，同比增长 443.96%到 604.47%。业绩同比增长较好原因主要有以下三点：一是从 3 月份起产能持续维持满载状态，上半年整体销量实现快速增长；二是非 DDIC 产品占主营业务收入比例大幅提升，其中 CIS 已成为公司第二大主轴产品；三是研发进展顺利，55nm 的 BSI 已经进入量产阶段，40nm 高压 OLED 也已实现小批量生产，28nm 产品开发正在稳步推进中。</p> <p>从现在来看，公司预期第三季度产能将继续维持满载，公司已根据市场情况对部分产品代工价格进行上调，后续将持续结合市场情况及产能利用率对代工价格进行相应调整。</p> <p>问题 2、公司车用芯片的导入情况？</p> <p>答复：公司已有部分产品进入后装市场，正在逐渐导入</p>

	<p>前装市场。</p> <p>问题 3、请问公司光罩业务进展如何？ 答复：公司长期致力于高精度光刻掩模版的研发，近日公司成功生产出首片半导体光刻掩模版，预计将于今年第四季度正式量产。</p> <p>问题 4、公司对采用国产化设备与材料的规划？ 答复：公司将在满足使用需求的前提下最大程度地采用国产化设备与材料，推动中国大陆供应链国产替代。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 7 月 25 日